

附件

## 2020 年度上海市“科技创新行动计划”集成电路 科技支撑专项项目立项清单

序号	项目编号	项目名称	承担单位	项目负责人	项目实施周期
1	20501110100	极紫外光刻用高温锡液滴压电微流控关键技术	中国科学院上海硅酸盐研究所	周志勇	2020-10-01 至 2023-09-30
2	20501110200	高端集成电路自动测试设备专用高密度高速互连链路设计及验证	上海御渡半导体科技有限公司	胡忠臣	2020-10-01 至 2023-09-30
3	20501110300	深紫外光刻级氟化钙晶体材料的研制	中国科学院上海硅酸盐研究所	姜大朋	2020-10-01 至 2023-09-30
4	20501110400	集成电路设备射频电源系统研发与验证	上海凯世通半导体股份有限公司	陈克禄	2020-10-01 至 2023-09-30
5	20501110500	面向集成电路纳米尺度三维多参数光学检测关键技术的研究	上海复享光学股份有限公司	殷海玮	2020-10-01 至 2023-09-30
6	20501110600	掩模板制造用多路并行超分辨激光直写设备关键技术研发	中国科学院上海光学精密机械研究所	曾爱军	2020-10-01 至 2023-09-30
7	20501110700	1200V 碳化硅平面 MOSFET 器件工艺制造关键技术及芯片开发与应用	上海积塔半导体有限公司	刘奇斌	2020-10-01 至 2023-09-30

序号	项目编号	项目名称	承担单位	项目负责人	项目实施周期
8	20501110800	1200V SiC MOSFET 制造及全 SiC 功率模块开发	上海功成半导体科技有限公司	王中健	2020-10-01 至 2023-09-30
9	20501110900	硅基氮化镓功率器件工艺库研发及功率集成电源转换电路设计与应用	上海新微半导体有限公司	XU DONG	2020-10-01 至 2023-09-30
10	20501120100	先进 BCD 车规级工艺平台的高可靠性器件制造工艺提升	上海华虹宏力半导体制造有限公司	张博	2020-10-01 至 2023-09-30
11	20501120200	车规级 3d TOF 传感芯片专用单光子 BCD 工艺及器件的开发与产业化	光梓信息科技(上海)有限公司	卓盛龙	2020-10-01 至 2023-09-30
12	20501120300	新一代高速低功耗嵌入式相变存储器芯片	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	宋三年	2020-10-01 至 2022-09-30
13	20501120400	集成电路制造超浅结退火激光关键技术研发及工艺研究	上海神光激光技术制造装备研发有限公司	张杰	2020-10-01 至 2022-09-30
14	20501120500	面向多协议高速接口芯片的检测技术研发与检测平台建设	上海华岭集成电路技术股份有限公司	王玉龙	2020-10-01 至 2022-09-30
15	20501120600	高速串行接口芯片信号完整性检测技术研发与检测平台建设	上海集成电路技术与产业促进中心	姜祁峰	2020-10-01 至 2022-09-30
16	20501130100	基于“存算一体”光子计算的关键器件和架构研究	复旦大学	程增光	2020-10-01 至 2022-09-30
17	20501130200	面向高开关比、低功耗逻辑器件应用的 4	中国科学院上海微系统与信息技术	于广辉	2020-10-01 至 2022-09-30

序号	项目编号	项目名称	承担单位	项目负责人	项目实施周期
		英寸高质量二硫化钼单晶晶圆制备	研究所		
18	20501130300	三维集成电路电磁全波仿真和参数提取技术研究	上海交通大学	肖高标	2020-10-01 至 2022-09-30
19	20501130400	三维集成电路功耗-温度-应力协同分析 EDA 关键技术研究	上海交通大学	唐旻	2020-10-01 至 2022-09-30
20	20501130500	基于人工智能的 EDA 多目标优化算法研究	上海交通大学	李平	2020-10-01 至 2022-09-30
21	20501130600	基于氧化物薄膜的微波无源可调电容与电感元件	复旦大学	顾宗铨	2020-10-01 至 2022-09-30
22	20501130700	智能 SOI 晶圆制备及新型三维瞬变电子器件研究	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	狄增峰	2020-10-01 至 2022-09-30